

FUJIMI

in Micro Cosmos

株式会社フジミインコーポレーテッド
株主通信・Vol.15（平成14年12月）
（第51期中間事業報告）

売上高、前年同期比12.9%増、
経常利益、同132.4%増を達成しました。

P1 中間連結決算ハイライト、
P9～ 財務諸表

こんな身近なところにも
研磨材が使われています。

P3～4 特集：もっと皆様の近くに。
広がる研磨材の用途

ISOって知っていますか？
品質保持への取り組みをお伝えします。

P7 ISO9001品質マネジメントシステム(QMS)の取り組み

ストックオプション
制度を導入しました。

P8 FUJIMI News

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

中間連結決算ハイライト

	第50期 平成14年3月31日現在	第50期中間期 平成13年9月30日現在	第51期中間期 平成14年9月30日現在
売上高	18,945	9,974	11,255
営業利益	274	461	1,146
経常利益	284	493	1,147
中間(当期)純利益	315	65	629
総資産	41,032	43,227	41,335
株主資本	35,314	35,603	34,513
一株当たり純利益(円)	20.43	4.24	41.26
一株当たり株主資本(円)	2,300.78	2,312.10	2,293.33
株主資本利益率(%)	0.9	0.2	1.8
総資産利益率(%)	0.7	0.2	1.5
株主資本比率(%)	86.1	82.4	83.5
一株当たり配当額(フジインコ・ボレ・テッド単体)	30.00円	15.00円	15.00円

平成14年度(第51期)中間連結決算のポイント

半導体ウェハー向け製品の売上高は、パソコンや携帯電話をはじめとする情報関連機器の在庫調整が一段落し、需要回復の兆しが見えはじめるなど比較的好調に推移しました。高性能が評価されているCMPスラリーも堅調に推移しましたが、ディスク向け製品については、依然としてディスクが供給過多の傾向にあり、デジタル家電への搭載が徐々に拡大しているものの市場の牽引役とまではいならず、売上高は減少しました。一方、水晶向け製品は水晶デバイスの回復を受け売上高は増加しました。営業経費面では、生産数量の増加により売上原価率が改善(前年同期比5.4ポイント減)した結果、

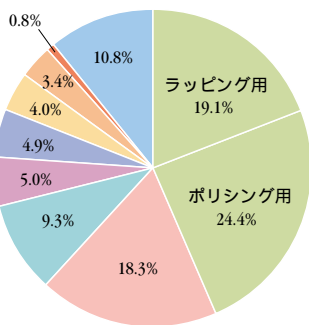
営業利益、経常利益はそれぞれ前年同期比148.4%、132.4%の大幅な増加となりました。中間純利益は、629百万円となりました。株主資本利益率は、前中間連結期の0.2%から当中間連結期は1.8%となりました。

1株当たり中間純利益は、41円26銭となりました。配当金は、1株15円とさせていただきます。

設備投資額は、4億33百万円であり、本社工場受変電設備更新、各務原工場設備およびコンピュータシステム構築などが主な内容です。なお、設備投資資金については、自己資金により充当しています。

主要用途別の製品売上高の特徴（連結）

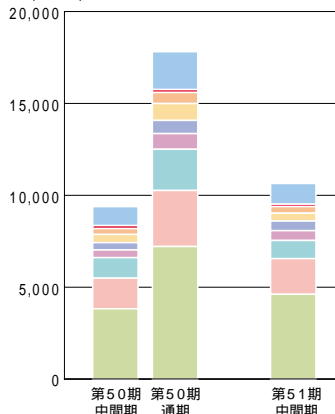
第51期中間期
用途別売上構成比



- 半導体ウェハー向け製品
- CMPスラリー
- ディスク向け製品
- 水晶デバイス研磨用
- ワイヤソー向け砥粒
- ガラス研磨用
- 一般ラッピング用
- 溶射材
- その他の製品

用途別売上高

(百万円)



グラフは商品を含めない自社製品のみの売上高です。

半導体ウェハー向け製品

パソコンを中心に、OA機器やAV製品など、電子産業関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンウェハーに代表される半導体基板を高精度に鏡面研磨しなければなりません。フジミのラッピング、ポリシング材はこの分野で高いマーケットシェアを誇っています。



売上高の特徴

今中間期は、昨年から継続していたパソコン、携帯電話、デジタルカメラなど最終製品の在庫調整が済み、新機種種の市場投入などが比較的活況に推移したことから、半導体需要は急速に回復しました。その結果、半導体ウェハー業界は高い工場稼働率を維持することができ、当社の半導体ウェハー向け製品(ラッピング用の「FO」やポリシング用の「GLANZOX(グランゾックス)」)の売上高は4,613百万円(前年同期比20.5%増)となりました。

CMPスラリー

半導体の集積度を上げるために半導体チップ上の多層配線の重要性が高まり、この多層化のための必須技術として実用されているのがCMP(化学的機械的平坦化)。フジミのもつ長年にわたるシリコンウェハー用のファイナルポリシング材開発ノウハウが応用展開可能な事業で、高成長が期待される分野です。



売上高の特徴

ほとんどのデバイスメーカーで導入が進むCMPの技術環境では、デザインルールの微細化に伴うマイクロクラッチ(微細傷)の発生問題やスラリーに含有される金属イオンの悪影響が深刻化しています。当社のCMPスラリー「PLANERLITE(プレナライト)」は、超高純度コロイダルシリカを主要な原料としており、それらの課題をクリアしているため、国内外のデバイスメーカーへの採用が進み、売上高は1,940百万円(前年同期比16.6%増)となりました。

ディスク向け製品

パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量メモリのハードディスクが注目を集めています。このため、ディスク研磨についても、より高精度な水準が要求されるようになりました。フジミはこの分野でも世界的に高い評価を得ています。



売上高の特徴

ハードディスク業界では未だに需給バランスの回復が遅れています。依然としてディスクが供給過多の傾向にあること、ハードディスクドライブ(HDD)はデジタル家電への搭載が拡大傾向にあるものの、未だ市場の牽引役とはなっていないことなどから、当社製品の売上高は989百万円(前年同期比11.5%減)と低迷しています。

水晶デバイス研磨用以下その他売上高の特徴

水晶デバイス事業では値引き要求が厳しく、単価下落が長期化していましたが、今上期にパソコンや携帯電話の需要が好転したことにより、水晶デバイスの生産が増加し、回復基調がもたらされました。当社の水晶デバイス研磨用製品の売上高は534百万円(前年同期比28.4%増)と好調に推移しました。ワイヤーソー向け砥粒は半導体ウェハーの切断に加えて太陽電池向け(ソーラーセル切断)用途が市場として成長してきた結果、売上高は522百万円(前年同期比31.0%増)となりました。溶射材は、サーメット溶射材「SURPREX」シリーズの新規採用が順調に進み、売上高は89百万円(前年同期比38.9%増)となりました。

CLOSE UP . . . フジミの事業をご理解いただくために

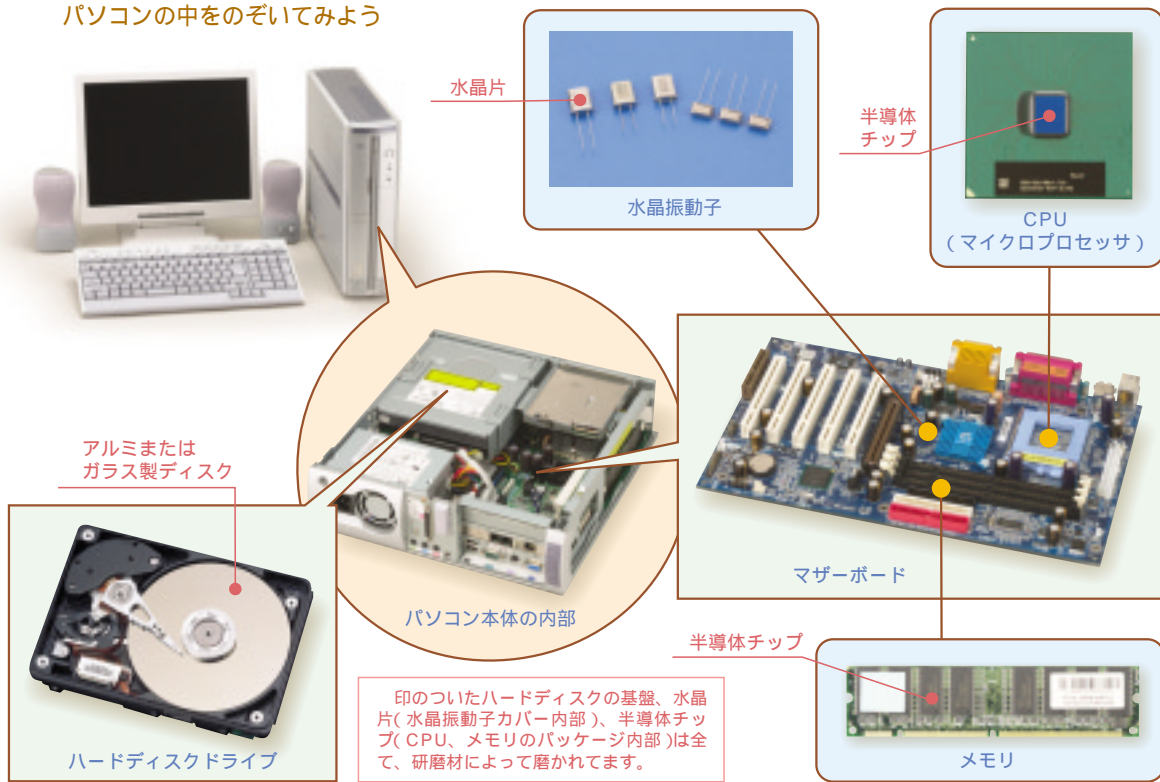
特集：もっと皆様の近くに。広がる研磨材の用途

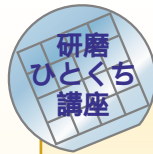
フジミの研磨材は何を磨いているの？

フジミの創始者が初めて国産第一号の光学レンズ用人造研磨材「FO」を世に送り出したのは1950年のこと。当時の用途は双眼鏡やカメラに使われる光学レンズ向けでした。その後、トランジスタ基板のゲルマニ

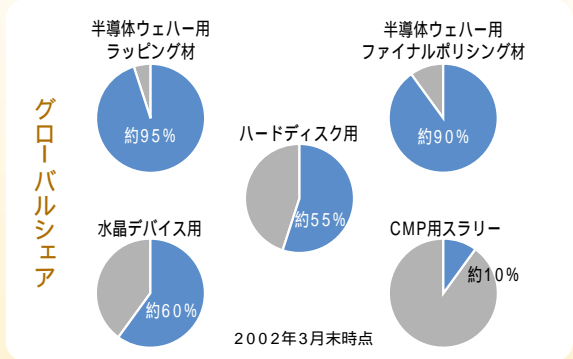
ウムウェハーをきっかけに、現在のフジミはパソコンや携帯電話、家電製品に組み込まれる半導体ウェハーやハードディスク、また水晶デバイスを磨く精密研磨材を世界中に提供しています。その研磨精度はシリコンウェハーのファイナルポリシングで3（*オングス

パソコンの中のをのぞいてみよう





トローム)前後と超微細な世界…。ちなみに今でもカメラ・メガネ・天体望遠鏡など光学レンズ用研磨材は扱っています。



パソコンにはフジミのテクノロジーがいっぱい

子供からお年寄りまで、パソコンは今や幅広い層で必須アイテムとなっています。パソコンには*メモリや*マイクロプロセッサなどの半導体デバイスや外部記憶装置であるハードディスクなどフジミの研磨材で磨かれた最先端の電子機器が搭載されています。例えば、半導体ウェハをピカピカに磨きあげるファイナルポリシング材「GLANZOX (グランゾックス)」。この製品は、インターネットや3Dグラフィック、動画とますます高度な処理能力が求められるパソコンの性能向上を支えるべく、1967年の開発以来、細粒化を重ね、完全鏡面化が要求される大口径300ミリウェハの時代まで世界中で今なお高い支持を得ています。

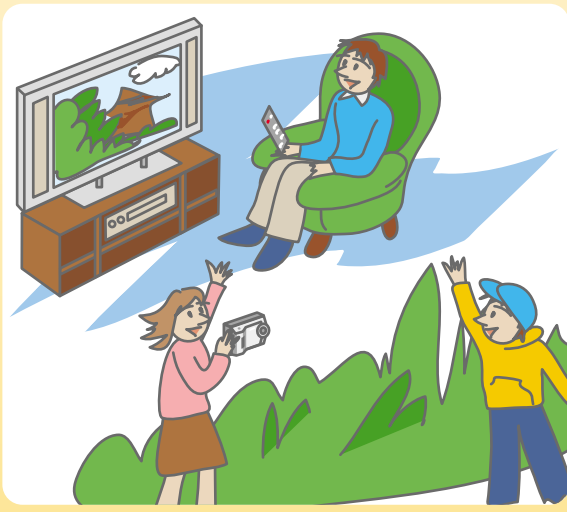
より便利に、快適に。進化するハイテク製品

私たちの暮らしに豊かさや快適さをもたらしてくれる最新エレクトロニクス。中でもデジタルカメラ、DVD(デジタル多用途ディスク)、カーナビゲーションシステムなどのデジタル家電は、20世紀のパソコン

シリコンウェハの製造は、研磨だけで、切断(ワイヤーソーによる) ラッピング 一次ポリシング 二次ポリシング ファイナルポリシングと5段階の工程を経ていきます。ラッピングとは、“ラップ”と呼ばれる上下の研磨皿の間に加工物を入れて回転させながら研磨する方法を、ポリシングとは、ラッピングよりもさらに細かい研磨材や薬品を用いて加工面を鏡面に仕上げる作業を言います。

ンの時代に続き、今後10年の半導体消費の牽引役となるだろうと言われています。

もちろん半導体のあるところは全て、フジミの技術フィールドです。デジタル家電に見られるように、私たち身の回りの電子機器が高性能化、小型化すればするほど、「最小限のチップ面積で最大限の処理を行う」、つまり「高集積・高速」の半導体デバイスがさらに必要とされ、それが半導体集積回路におけるデザインルールの微細化や*多層配線化といった流れを生み出して



います。フジミでは、こうした流れに対応する高精度な研磨材および加工方法をいち早く研究しお客様に提供しています。

広がるパウダーテクノロジーの未来

2002年9月、米国の子会社フジミアメリカが、多層配線で用いられる*CMPスラリーの分野において、超高純度コロイダルシリカを採用した銅配線向けの新しいシリーズの出荷を開始しました。消費電力を減らし、処理速度を飛躍的に高める銅配線は、次世代の半導体デバイスの鍵を握る技術の一つとして大きな注目を集めています。同シリーズはすでに日本で生産していますが、フジミアメリカが本格的に生産・供給を行うのは今回が初めてです。

また研磨材の応用展開から生まれた*溶射材は現在、掘削機や建設機械などに使用されていますが、今後は環境にやさしい新材料としてメッキの代替需要も見込まれるなど、従来にない新しい用途の開拓が期待されています。

「磨く」技術と微粉を扱う「パウダーテクノロジー」を核に、フジミが切り開く新しい用途、新しい市場はこれからも皆様の暮らしをより快適に、より楽しくしていきます。

オングストローム：100億分の1メートル。ちなみに原子の大きさは1オングストローム前後。

メモリ：文書データやプログラムデータなどさまざまな情報を記憶する装置。マイクロプロセッサ：超小型の演算処理装置。コンピュータシステムの中心にあり、プログラムの実行や各種演算を集中的に行う。

多層配線：LSI（大規模集積回路）、超LSIといった半導体デバイスでチップサイズを大きくすることなく、高集積を達成するために、金属配線を何層にも積み重ね、立体的な配線構造をつくる技術。

CMP：化学的機械的平坦化のこと。多層配線において回路を積み上げる際に絶縁膜や配線の凹凸をならす技術。

溶射材：溶射とは熱や磨耗、腐食などから守るために、素材の表面を金属やセラミックスを溶かしながらコーティングすることで、溶射材はその材料をさす。

株主の皆様へ

回復の兆しを見せた半導体市場

2002年は、パソコンや携帯電話をはじめとする製品の在庫調整が完了し、世界的に需要回復の兆しを見せるなど半導体市場にとって好スタートの幕開けとなりました。半導体メーカー各社で半導体部品の在庫の積み増し戦略が敢行され、工場の稼働率が急上昇するなどシリコンウェハー業界へ好影響を及ぼしたことから、当社のシリコンウェハー向け研磨材の当中間期の連結売上高も前年同期比20.5%増の46億円と大幅な増加を達成いたしました。

ウェハー向け研磨材の好調な需要に加え、今年から300ミリウェハーの生産が各社月産数万枚レベルで開始されています。配線幅0.13マイクロメートルまで微細化の進んだ300ミリウェハーでは今まで以上の高精度研磨を希望する顧客が増えており、精度の高さで定評のある当社への期待も大きくなっています。

CMPスラリーも計画を上回り好調に推移しました。特に、当社が製造する超高純度コロイダルシリカをベースとしたスラリーは、半導体デバイスの品質に深刻なダメージを与える金属イオンなどの不純物を含まないため、加工対象である金属配線や絶縁膜などに傷が付きにくいなど高い性能が評価されており、線幅0.13マイクロメートルや銅配線を採用した最新の半導体製造ラインで需要が急増しています。

一方、ハードディスク向け研磨材は、ハードディスクが供給過多の傾向にあること、デジタル家電への搭載が拡大傾向にあるものの、まだ市場の牽引役とまではなっていないことなどから引き続き厳しい状況を余儀なくされました。

今後の見通し、経営戦略

デジタルカメラやDVDプレーヤーなどのデジタル家電が需要の牽引役として台頭してきているものの、半導体用途の大きな割合を占めるパソコンやサーバーなどの最終需要の伸びが不透明であることから市場の本格的な回復は来年以降になるだろうと予想されています。

一方、低価格な中国製研磨材の台頭や大手化学メーカーによるスラリー事業への参入など業界内の競争も激化しています。こうした状況のもと、フジミでは競争の激しい市場での優位性を堅持するために、従来分野においてはこれまで以上に高い品質と安定的な供給、迅速な開発レスポンスとサービスを提供するとともに、半導体などの市況変動に左右されない柔軟な収益構造の構築に向けて、溶射材やCMP分野を筆頭に新規事業・新用途の早期開拓および育成を実現することを最優先課題に据えて現在取り組んでいるところです。

今年9月、フジミアメリカで高純度コロイダルシリカを用いた銅配線用CMPスラリーの生産をいよいよ開始しました。成長分野で

ある銅配線用スラリーは、スラリーメーカー各社がしのぎを削っている状況ですが、本格的な需要拡大を目前にして、米国にいち早く生産供給体制を整えることは、当社のCMPスラリー戦略の前進に向けた大きな一手となると考えています。

株主へのメッセージ

今年7月にストックオプション制度を導入しました。これにより取締役および従業員の業績向上への意欲を高めるとともに、企業価値(=株主価値)の上昇を目指す経営を徹底させるのが狙いです。「2003年3月期にROE2.5%以上、2007年3月期までにROE10%以上」の必達に向けてグループ一丸となって鋭意努力しておりますので、株主の皆様におかれましては今後とも末永いご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成14年12月
代表取締役社長

越山 彰



代表取締役社長 越山 彰

ISO9001 品質マネジメントシステム(QMS)の取り組み

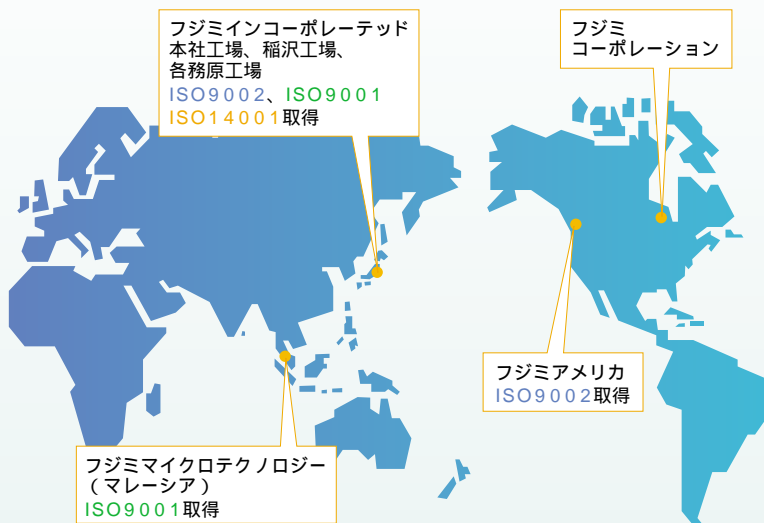
どんなに素晴らしい製品でも、品質がばらばらではお客様に安心してお使いいただけません。
今回は、品質保持に向けたこれまでの取り組みをご紹介します。

業界でいち早く品質システムを導入

フジミは、1994年に品質保証の国際規格ISO9002を、1999年にISO9001を取得しました。出荷量の約50%を輸出が占める当社では、国際的に通用する品質保証体制を構築する必要があったからです。

これら品質システムは、仕事のやり方を決め、それを文書化し、決めたとおりにやった証拠を記録として残すことを要求しています。しかし、取得までの準備段階では、熟練の技術者から「仕事のやり方をきちんと決めることは個人の要領を許さないことになる」「いい製品をつくっているのになぜそんなシステムが必要なのか」など、はじめは困惑の声も聞かれました。

ISOを取得する工場



ISO14000シリーズは企業が自主的に環境への負荷を低減するシステムを築くことを求める環境管理の国際規格です。

お客様が満足できる品質の提供を

お客様からISO9001に則った要望が増えるにつれ、社内のISO9001に対する理解も次第に深まってきました。仕事の細部にわたり責任と権限がはっきりしたことで、品質異常に対する処置も迅速に進めることができ、その必要性を実感できるようになりました。

今年8月、当社はISO9001の2000年度改訂版を取得しました。この改訂

では、顧客満足、経営者のリーダーシップ、継続的改善が要求されています。この内容からも分かるとおり、改善活動から発展したTQMの考え方が多く取り入れられました。フジミでは、今回の改訂の主旨を全社員が理解し、より効率の良い効果的な品質マネジメントシステムを構築・実行することにより、弊社の品質方針である「顧客満足を高める質の創造と提供」を実現していきます。

品質方針

顧客満足を高める
質の創造と提供

年度品質目標
2003年3月期
ROE2.5%以上を
達成する
(中期目標：2007年
3月期ROE10%以上)

自己株式を取得

2002年7月に、商法第210条の規定に基づき自己株式の取得を行いました。今回取得した株式数は298,400株で、取得総額は760,920千円となりました。これにより、経営環境の変化に対応した機動的な経営が行える状況が整いました。

ストックオプション(自社株購入権)制度を導入

商法第280条ノ20および280条ノ21の規定に基づき、ストックオプション制度を導入することが6月26日に開催した第50期定時株主総会において承認可決されました。対象となるのは、当社の取締役、監査役および課長以上の従業員、ならびに子会社の取締役およびオフィサーです。当社および子会社の取締役、従業員の連結業績の向上に対する意欲と士気を高め、また当社監査役の企業統治機能を一層高めることにより、健全な経営と社会的信頼の向上を図ることが今回の導入の目的です。

フジミアメリカが銅配線向けCMPスラリーの生産を開始

2002年9月より、子会社であるフジミアメリカ(米国オレゴン州)が、銅配線向けCMPスラリー「PLANERLITE-7000」シリーズの生産・供給を開始しました。不純物の含有量が極端に少なく、半導体基板に傷をつけにくいなどの利点をもつ超高純度コロイダルシリカを原料に用いた本製品は、微細化の進展する次世代の半導体デバイス製造において歩留まりを飛躍的に向上する研磨材として、高い注目を集めています。これまで国内外の供給は各務原工場(岐阜県)が一手に引き受けていましたが、米国内に生産供給体制が整うことで、現地の顧客メーカーに対して、より迅速かつきめこまかなサービスを提供できることになりました。



「PLANERLITE-7000シリーズ」



フジミアメリカ

世界初、HVOF(高速フレイム溶射)による微粉末溶射に成功

HVOF(高速フレイム溶射)を使った微粉末溶射システムを世界で初めて確立しました。「ガン」と呼ばれる微粉末溶射に適したHVOFと「微粉末送給機」とを初めて組み合わせ、当社の製造する微粉末溶射材を適用する「三位一体」によるこのシステムは、溶射によってできる皮膜が非常に緻密で、平均表面粗さで1マイクロメートル以下の滑らかさを達成しました。溶射材の変質もほとんど起こらないため、耐腐食・耐高温・耐磨耗性でも従来の溶射技術では決して得られなかった品質を提供することが可能です。また、表面粗さが障壁となっていた*クロムメッキから*サーメット溶射材への代替もこれによって加速されると見込んでいます。本格的な事業開始は2003年度からを予定しています。

クロムメッキ：硬質クロムメッキのこと。耐磨耗性が要求される工業部材のコーティング材として幅広く使われるが、処理工程中に有害物質を排出するため、環境面で近年問題となっている。

サーメット溶射材：金属とセラミックスを成分として複合化した溶射材。耐熱・耐食・耐磨耗に優れることからメッキの代替材として有望視される。

中間連結貸借対照表

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

流動資産

売上の増加により、現預金および受取債権が増加し、流動資産は前期末比13.5億円増加しました。

固定資産

当中間期の設備投資は、本社工場受変電設備更新、各務原工場設備および各務東町工場設備など4.3億円となりました。一方、減価償却は11.4億円実施したため、有形固定資産は前期末比10.4億円の減少となりました。無形固定資産は、連結調整勘定の償却などにより0.2億円減少しました。投資その他の資産は、著変はありませんでした。

負債

流動負債は、前期末比11.4億円増加しました。短期借入金の返済による減少(4.4億円)があったものの、利益増による未払法人税の増加および原材料ほか仕入の増加による支払債務等により増加となりました。固定負債の「その他」は、繰延税金負債、退職給付引当金などですが、著変はありませんでした。

株主資本

自己株式の取得(7.6億円)を主因として、株主資本は8.0億円減少し、株主資本比率は2.6ポイント減の83.5%となりました。

	第50期 平成14年3月31日現在	第50期中間期 平成13年9月30日現在	第51期中間期 平成14年9月30日現在
資産の部			
流動資産	21,669	22,722	23,023
現金及び預金	7,312	5,455	12,184
受取手形及び売掛金	5,981	6,312	6,752
棚卸資産	3,403	3,957	3,047
短期貸付金	2,008	6	6
その他流動資産 (貸倒引当金)	2,982	7,003	1,038
	17	13	5
固定資産	19,362	20,505	18,311
有形固定資産	16,912	17,988	15,866
無形固定資産	571	582	547
投資その他の資産	1,878	1,934	1,897
資産合計	41,032	43,227	41,335
負債の部			
流動負債	4,625	6,465	5,768
支払手形及び買掛金	2,281	2,869	2,753
短期借入金	1,359	1,377	915
その他流動負債	984	2,217	2,100
固定負債	1,060	1,130	1,022
長期借入金	—	37	—
その他	1,060	1,092	1,022
負債合計	5,685	7,595	6,791
少数株主持分			
少数株主持分	32	28	29
資本の部			
資本金	4,753	4,753	4,753
資本準備金	5,038	5,038	5,038
連結剰余金	24,751	25,336	25,150
その他有価証券評価差額金	1	71	1
為替換算調整勘定	771	546	338
自己株式	1		765
資本合計	35,314	35,603	34,513
負債及び資本合計	41,032	43,227	41,335

中間連結損益計算書

売上高

シリコンウェハー用ラッピング材およびポリシング材の売上高は、情報関連機器の在庫調整がほぼ終結し、半導体市場の需要回復の兆しが見えはじめ、大きく好転しました。CMPスラリーも当社の高性能品が評価され、堅調に推移しました。ハードディスク用ポリシング材は家電製品への搭載が期待されるものの、まだ需要回復の牽引役にはならず、厳しい状況が続きました。研磨機等機械の商品売上も半導体設備投資需要の本格的復調とまではいかなかったものの、総売上高は前年同期比12.9%の増加となりました。

営業利益

売上の増加により売上原価率は前年同期比5.4ポイント減少し、販売費及び一般管理費のうち研究開発センターの減価償却費が増加しましたが、人件費ほか営業経費の削減に努めた結果、営業利益は同148.4%の大幅な増加となりました。

経常利益・中間純利益

営業外損益は超低金利の状況下、改善がみられませんでした。売上高経常利益率は前年同期比5.2ポイント向上し、経常利益は同132.4%増の11.4億円となりました。その結果、中間純利益は6.2億円となりました。また、株主資本利益率(ROE)は、前年同期比2.0ポイント増の1.8%となりました。

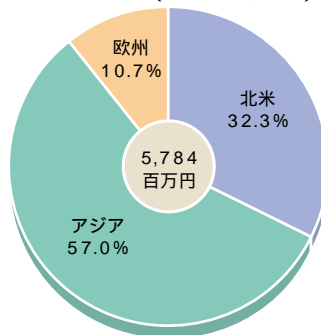
(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第50期中間期 平成13年4月1日から 平成13年9月30日まで	第51期中間期 平成14年4月1日から 平成14年9月30日まで
売上高	18,945	9,974	11,255
売上原価	14,281	7,404	7,752
販売費及び一般管理費	4,389	2,107	2,356
営業利益	274	461	1,146
営業外収益	108	76	56
受取利息/配当金	41	43	35
その他	67	33	20
営業外費用	99	43	54
支払利息	56	25	21
有価証券売却損	32	—	—
その他	10	18	33
経常利益	284	493	1,147
特別利益	9	16	13
特別損失	641	369	11
税引前中間(当期)純利益	347	141	1,149
法人税、住民税及び事業税	70	250	832
過年度法人税等	93	—	—
還付法人税等	125	—	—
法人税等調整額	76	48	314
少数株主利益	5	5	1
中間(当期)純利益	315	65	629

海外売上高 (百万円)

	第50期中間期	第51期中間期
海外売上高	4,959	5,784
(連結売上高)	(9,974)	(11,255)
海外売上高の 連結売上高に 占める割合(%)	49.7	51.4

海外売上高構成比(第51期中間期)



*各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。
 北米： 米国、カナダ
 アジア：台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
 欧州： イギリス、デンマーク、ドイツ

中間連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

営業活動による キャッシュフロー

営業活動の結果得られた資金は、32.6億円(前年同期比14.8億円の増)となりました。これは中間純利益の増加と、棚卸資産の減少(2.3億円)および還付法人税等によるものです。

投資活動による キャッシュフロー

投資活動の結果使用した資金は1.6億円となりました。これは主に有価証券を売却したこと、無形固定資産への投資を含めた設備投資関連支出を抑制し2.4億円の支出にとどめたことによるものです。

財務活動による キャッシュフロー

財務活動の結果使用した資金は13.3億円(前年同期比74.3%増)となりました。これは主に自己株式の取得(同7.6億円)および借入金の約定弁済(同3.4億円)によるものです。

現金及び現金同等物は、自己株式の取得による支出が7.6億円あったものの、税金等調整前中間純利益が11.4億円となり、設備投資関連による支出が2.4億円と減価償却費の実施額11.4億円を大きく下回ったことにより、前期末比19.8億円増加し、期末残高は123.8億円となりました。

	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第50期中間期 平成13年4月1日から 平成13年9月30日まで	第51期中間期 平成14年4月1日から 平成14年9月30日まで
営業活動によるキャッシュフロー	2,332	1,783	3,268
税金等調整前中間(当期)純利益(損失)	347	141	1,149
減価償却費	2,482	1,170	1,149
連結調整勘定償却額	163	81	81
売上債権増減額	2,977	2,583	897
仕入債務増減額	1,714	1,087	565
棚卸資産増減額	330	280	239
その他	287	214	957
小計	4,180	2,824	3,244
利息及び配当金の受取額	41	43	35
法人税等の支払額	2,143	1,058	9
その他	254	25	21
投資活動によるキャッシュフロー	3,905	2,403	161
定期預金の預入による取得	500	500	—
有価証券の取得による支出	549	204	99
有価証券の売却による収入	254	204	512
有形固定資産取得による支出	2,749	1,618	137
その他	360	284	113
財務活動によるキャッシュフロー	1,227	767	1,338
短期借入金の純増加(減少)額	256	194	344
長期借入金の返済による支出	437	253	—
自己株式取得による支出	542	435	763
配当金の支払	504	273	230
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	45	110
現金及び現金同等物の増加(減少)額	2,760	1,342	1,982
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	90	90	—
現金及び現金同等物期首残高	13,072	13,072	10,402
現金及び現金同等物期末残高	10,402	11,820	12,384

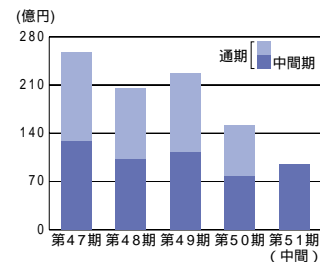
中間単体決算の概要

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

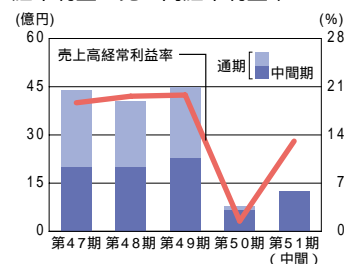
中間損益計算書	第50期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	第50期中間期 平成13年4月1日から 平成13年9月30日まで	第51期中間期 平成14年4月1日から 平成14年9月30日まで
売上高	15,207	7,776	9,522
売上原価	10,982	5,452	6,490
販売費及び一般管理費	3,514	1,689	1,851
営業利益	709	633	1,179
営業外収益	86	55	78
営業外費用	50	21	7
経常利益	745	667	1,249
特別損益	599	335	1
税引前中間(当期)純利益	146	332	1,251
法人税、住民税及び事業税	63	140	828
法人税等調整額	32	3	298
中間(当期)純利益	115	187	720
前期繰越利益	1,276	1,276	395
中間配当額	230	—	—
自己株式消却額	535	430	—
中間(当期)未処分利益金	625	1,033	1,116

中間貸借対照表	第50期 平成14年3月31日現在	第50期中間期 平成13年9月30日現在	第51期中間期 平成14年9月30日現在
資産の部			
流動資産	18,596	19,699	20,365
固定資産	19,308	20,340	18,780
資産合計	37,905	40,040	39,145
負債・資本の部			
流動負債	3,165	4,911	4,707
固定負債	969	1,022	942
負債合計	4,134	5,933	5,650
資本金	4,753	4,753	4,753
法定準備金	5,401	5,401	—
剰余金	23,615	24,023	—
資本剰余金	—	—	5,038
利益剰余金	—	—	24,469
有価証券評価差額金	1	71	1
自己株式	—	—	765
資本合計	33,770	34,106	33,494
負債及び資本合計	37,905	40,040	39,145

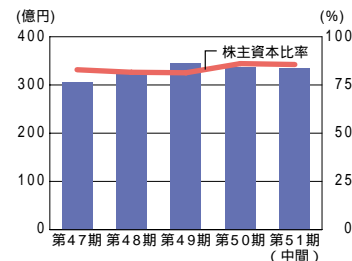
売上高



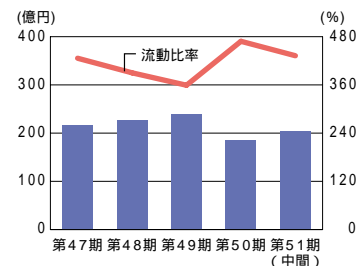
経常利益・売上高経常利益率



株主資本・株主資本比率

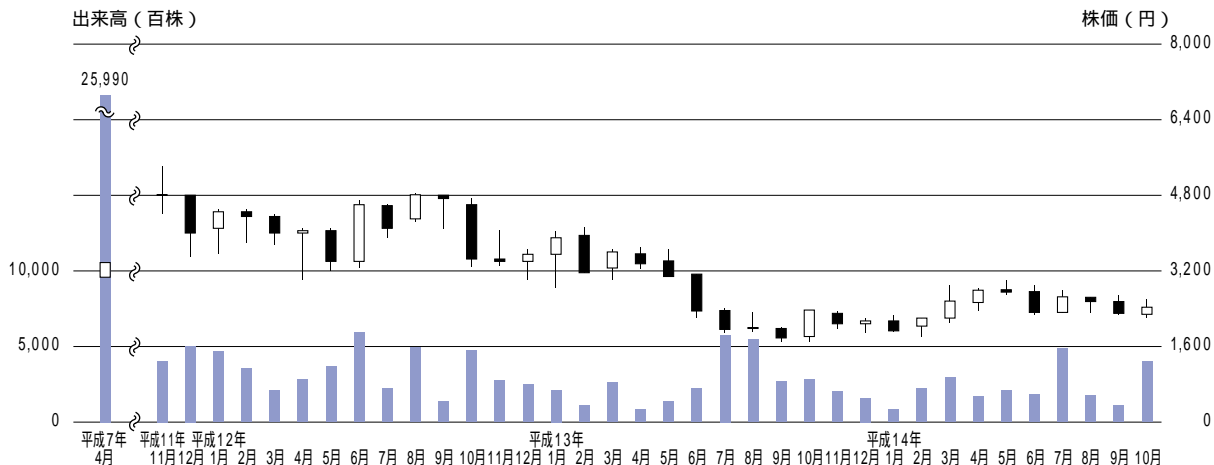


流動資産・流動比率

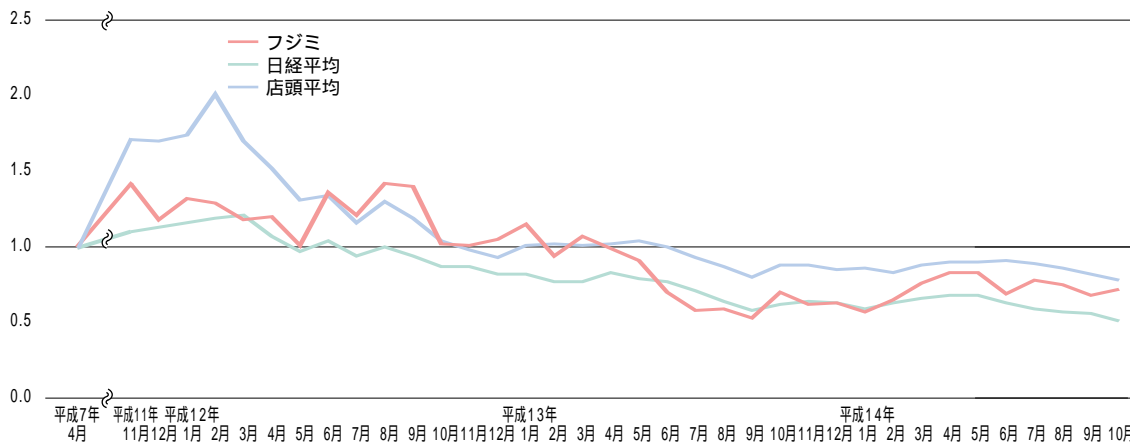


第47～50期は年度末の数値、第51期は中間期末の数値となっています。

株価および出来高の推移



株価の推移比較（フジミ・日経平均・店頭平均）



* 毎月の終値を、フジミが店頭公開した平成7年4月の株価（4月の終値）を1として指数化しています。フジミの株価が市場全体の動きに比べて、どのように変動しているかを示しています。

会社データ (平成14年9月30日現在)

商号

株式会社フジインコーポレーテッド

証券コード

5384

本社所在地

愛知県西春日井郡西枇杷島町地領2丁目1番地の1
TEL. 052-503-8181(代表)

設立年月日

昭和28年3月20日

資本金

4,753,438,500円

代表者

代表取締役社長 越山 彰

従業員

359名

役員

代表取締役会長	越山 勇
代表取締役社長	越山 彰
専務取締役	中村 定夫
取締役	藤本 俊之
取締役	久保 昌昭
取締役	永利 正
取締役	児玉 一志
取締役	中川 博行
取締役	松島 伸男
常勤監査役	新家 秀孝
監査役	大矢 晃三
監査役	池本 富春
監査役	鮎澤 多俊

株主メモ (平成14年9月30日現在)

株式の状況

株式数

会社が発行する株式の総数	39,747,300株
発行済株式総数	15,349,750株
株主数	5,168名

大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	1,934,155株	12.6%
野田 純孝	1,420,000	9.3
日本トラスティ・サ・ビス信託銀行株式会社 (信託口)	691,300	4.5
UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口)	686,500	4.5
株式会社あさひ銀行	595,892	3.9
有限会社コマ	577,180	3.8
越山 彰	530,700	3.5
日本生命保険相互会社	389,940	2.5
株式会社UFJ銀行	326,025	2.1
第一生命保険相互会社	316,200	2.1

決算期

3月31日

基準日

3月31日

1単元の株式の数

100株

公告掲載新聞

日本経済新聞

名義書換代理人

東京都中央区日本橋茅場町
1丁目2番4号

同事務取扱場所

日本証券代行株式会社
本店および各支店

名古屋市中区栄
3丁目3番17号
名古屋証券会館5階

日本証券代行株式会社
名古屋支店

同取次所

日本証券代行株式会社
本店および各支店

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画室企画課

TEL：052 - 503 - 8181（代表）

ホームページアドレス：<http://www.fujimiinc.co.jp>